

特徴

- 銅端子の優れた導電性
- 優れた長期安定性
- 高いピーク電力に対する耐性
- RoHS、REACH認証
- AEC-Q200 認証
- 要求ベースで銅端子部のメッキ対応も可能

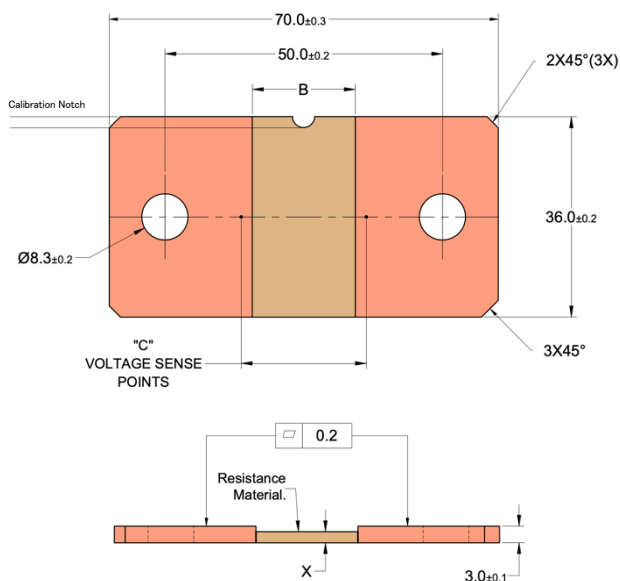


アプリケーション

- xEVのバッテリー管理システムの電流検出
- バスバーの電流検出
- 溶接機の電流検出

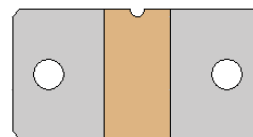
技術データ

| | | |
|--------------------------------|---|---------|
| 抵抗値 | 0.025 0.035 0.050 0.100 | (mΩ) |
| 抵抗値公差 (R) | 5% ,10% (+/- 10% for 0.025mΩ) | (%) |
| TCR - 抵抗合金 (20-60°C) | < ± 10 (Copper Manganese Alloys) | (ppm/K) |
| TCR - 部品 (20-60°C) | < ± 150 for 0.025, 0.035, 0.05 mΩ | (ppm/K) |
| | < ± 75 for 0.1 mΩ | |
| 使用温度範囲 | - 55 ~ +170 | °C |
| 定格電力 | 36 | W |
| インダクタンス | < 3 | nH |
| 熱起電力 | < 1 | μV/°C |
| 耐久性 * T _t = 端子温度 | < 0.5 after 2000 Hours, T _t *= 110°C | % |
| | < 1.0 after 2000 Hours, T _t *= 140°C | % |

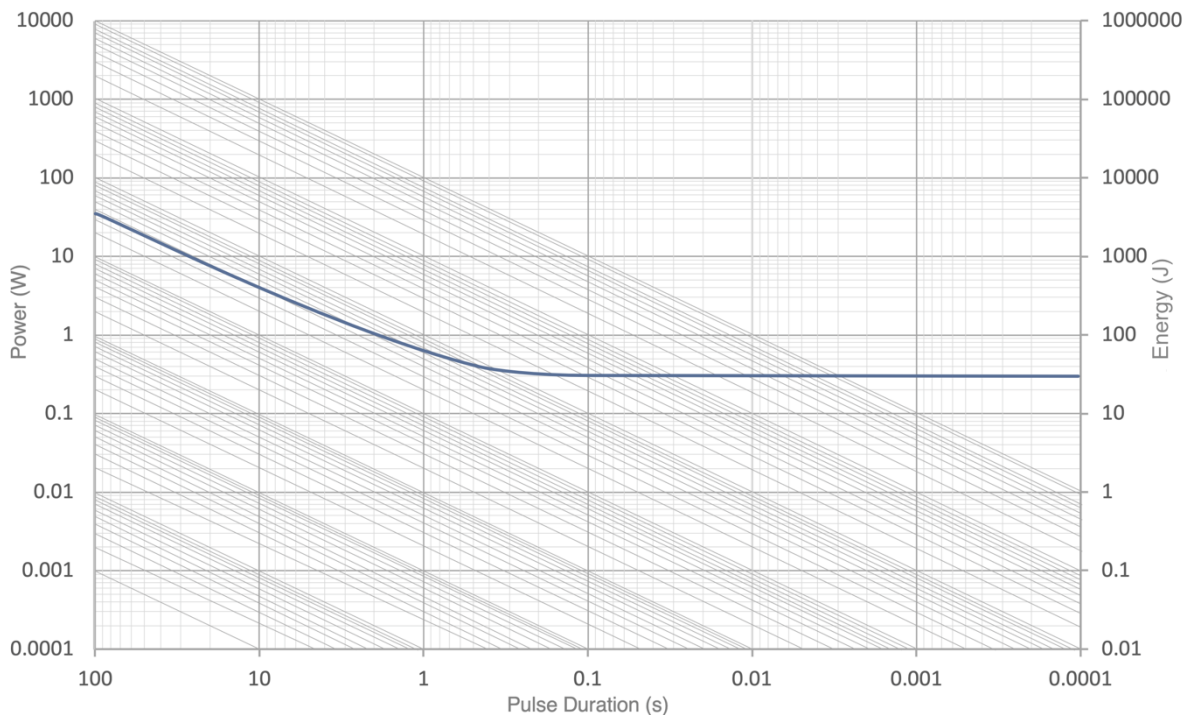
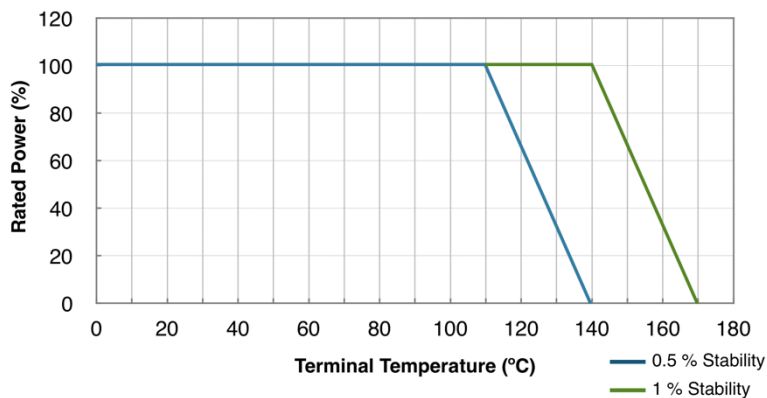


*メッキ対応

- RoHS認証のメッキ
- 標準は錫メッキ: 厚さ2.5~8 μm
- 要求ベースで、ニッケル下地0.5~4 μm可能
- 基本材料: 無酸素銅 1/2H



電力軽減曲線 R: 0.1mΩ



最大パルスエネルギー曲線

梱包

| 袋詰め | トレイ |
|----------------|-----------|
| 窒素充填のビニールバッグ入り | トレイ当たり15個 |

| SBZ 7036 | | | | | |
|----------------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 部品番号 | 抵抗値 (mΩ) | 寸法 (X) +/-0.20 (mm) | 寸法 (B) +/-0.50 (mm) | 寸法 (C) +/-0.20 (mm) | 抵抗砲金 |
| SBZ-7036-CM2-R000025 | 0.025 | 2.20 | 4.50 | 7.70 | Copper Manganese Alloy |
| SBZ-7036-CM2-R000035 | 0.035 | 2.20 | 6.20 | 9.40 | Copper Manganese Alloy |
| SBZ-7036-CM2-R000005 | 0.05 | 2.20 | 9.00 | 12.20 | Copper Manganese Alloy |
| SBZ-7036-CM2-R0001 | 0.10 | 2.00 | 16.50 | 19.70 | Copper Manganese Alloy |

特性:

| 試験項目 | 参照基準 | 試験条件 | 合格基準 |
|----------|-------------------------|-------------------------------|---------------|
| 高温放置 | MIL-STD-202 Method 108 | 170°C環境で1000時間、通電なし | ΔR +/-1% |
| 温度サイクル | JESD22 Method JA-104 | -55°C~150°C, 1000サイクル, 各30分 | ΔR +/-0.5% |
| 高温高湿バイアス | MIL-STD-202 Method 103 | 85°C & 湿度85%, 動作電力10%, 1000時間 | ΔR +/-0.5% |
| 高温寿命 | MIL-STD-202 Method 108 | 定格電力下で125°C, 1000時間 | ΔR +/-1% |
| 外観 | MIL-STD-883 Method 2009 | 目視検査 | 目視で異常なし |
| 寸法 | JESD22 Method JB-100 | 図面の寸法に従う | 図面の公差内 |
| 溶剤耐性 | MIL-STD-202 Method 215 | 水性化学物質で洗浄 | レーザー刻印に影響ないこと |
| 振動 | MIL-STD-202 Method 213 | 100gを6ミリ秒間, 正弦半波パルス | ΔR +/-0.2% |
| はんだ耐熱性 | MIL-STD-202 Method 204 | 5gを20分, 3方向から12サイクル, 10-20 | ΔR +/-0.2% |
| はんだ濡れ性 | MIL-STD-202 Method 210 | はんだ温度260°C, 10秒 | ΔR +/-0.5% |
| 電気的特性 | J-STD-002 | J-STD-002 に従う | 10倍の倍率で95%以上 |
| 短時間過電流負荷 | ユーザー仕様 | 定義された抵抗値 | 仕様の公差内 |
| 低温貯蔵 | -- | 定格電流の5倍を5秒 | ΔR +/-0.5% |
| | -- | -65°C, 24時間 | ΔR +/-0.2% |

SBZ 7036 シリーズ

低抵抗電子ビーム溶接精密抵抗器

発注コード例: SBZ-7036-CM2-R0001-5-U-BK
 (例: 0.1mΩ SBZ 7036, メッキなし, 袋詰め出荷)

